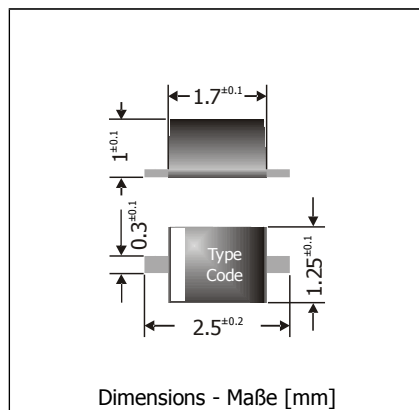


MM3Z2B4 ... MM3Z47B (200 mW - 2%)
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
Silizium-Planar-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2012-08-22



Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	200 mW
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung	2.4...47 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ SOD-323
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



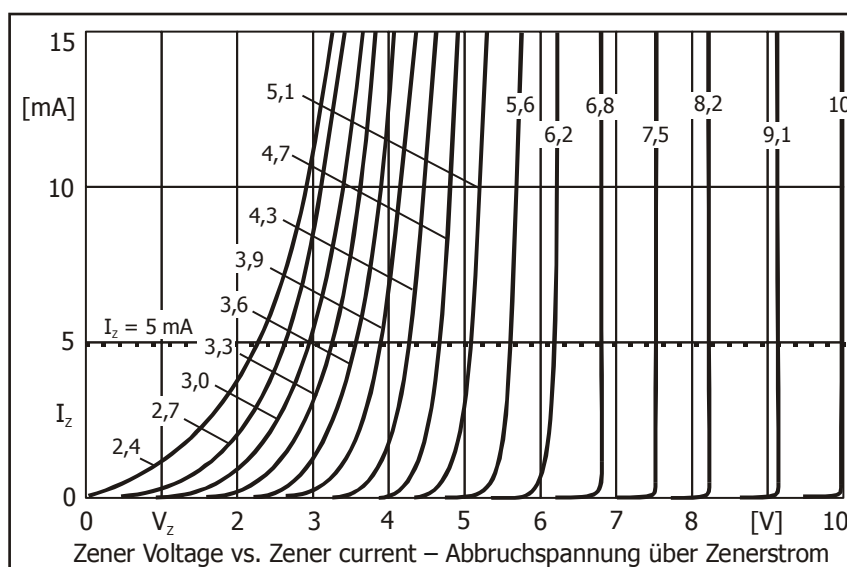
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.

Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics**Grenz- und Kennwerte**

		MM3Z-series	
Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	200 mW ¹⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 620 K/W ¹⁾
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite			



¹ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Code	Zener voltage ¹⁾ Zener-Spanng. ¹⁾ $I_Z = 5 \text{ mA}$		Dynamic resistance Inhär. diff. Widerstand $r_{Zj} [\Omega]$ at $f = 1 \text{ kHz}$	Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng.	Reverse voltage Sperrspannung V_R at/bei I_R		Z-current ²⁾ Z-Strom ²⁾ $T_A = 25^\circ\text{C}$
MM3Z...		$V_{Zmin} [\text{V}]$	$V_{Zmax} [\text{V}]$	$I_Z = 5 \text{ mA}$	$\alpha_{VZ} [10^{-4}/^\circ\text{C}]$	$V_R [\text{V}]$	$I_R [\mu\text{A}]$	$I_{Zmax} [\text{mA}]$
2B4	DN	2.35	2.45	100	-8...-5	1	120	85
2B7	DP	2.64	2.75	110	-8...-5	1	120	76
3B0	DR	2.94	3.06	120	-8...-5	1	50	68
3B3	DX	3.23	3.37	130	-8...-5	1	20	62
3B6	DY	3.52	3.67	130	-8...-5	1	10	57
3B9	DZ	3.82	3.97	130	-8...-5	1	05	52
4B3	Z0	4.21	4.386	130	-7...-4	1	05	48
4B7	EB	4.60	4.794	130	-5...-2	1	02	43
5B1	EC	4.99	5.202	130	-2...+2	1.5	02	40
5B6	ED	5.48	5.712	80	-1...+4	2.5	01	36
6B2	EE	6.07	6.324	50	+2...+5	3	01	33
6B8	EF	6.66	6.936	30	+3...+6	3.5	0.5	30
7B5	EH	7.35	7.65	30	+3...+6	4	0.5	27
8B2	EJ	8.04	8.364	30	+4...+7	5	0.5	25
9B1	EK	8.92	9.282	30	+4...+7	6	0.5	22
10B	EM	9.80	10.2	30	+5...+8	7	0.1	20
11B	EN	10.78	11.22	30	+5...+8	8	0.1	19
12B	EP	11.76	12.24	35	+5...+8	9	0.1	17
13B	ER	12.74	13.26	35	+6...+9	10	0.1	16
15B	EX	14.70	15.3	40	+6...+9	11	0.1	14
16B	EY	15.68	16.32	40	+6...+9	12	0.1	13
18B	EZ	17.64	18.36	45	+6...+9	13	0.1	11
20B	FA	19.60	20.4	50	+6...+9	15	0.1	10
22B	FB	21.56	22.44	55	+7...+10	17	0.1	9
24B	FC	23.52	24.48	60	+7...+10	19	0.1	9
27B	FD	26.46	27.54	70	+7...+10	21	0.1	8
30B	FE	29.40	30.6	80	+7...+10	23	0.1	7
33B	FF	32.34	33.66	80	+7...+10	25	0.1	6
36B	FH	35.28	36.72	90	+7...+10	27	0.1	6
I_T		2.5mA		2mA				
39B	FJ	38.22	39.78	100	+7...+10	30	2	5
43B	XJ	42.14	43.86	130	+7...+10	33	2	5
47B	XK	46.06	47.94	150	+7...+10	36	2	4

1 Tested with pulses $t_p = 5 \text{ ms}$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 5 \text{ ms}$

2 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss